

7、对 JCET STATS CHIP PAC KOREA LIMITED（长电韩国）担保不超过 100,000 万元。

8、对星科金朋半导体（江阴）有限公司担保不超过 20,000 万元。

2017 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、长电科技（宿迁）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 15,000 万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2016 年总资产为 98,117.21 万元；净资产为 -5,479.39 万元；营业收入 67,719.90 万元；净利润 -2,201.01 万元。

2、长电科技（滁州）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 30,000 万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2016 年总资产为 129,548.15 万元；净资产为 58,975.81 万元；营业收入 140,168.71 万元；净利润 15,785.61 万元。

3、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司，母公司持股 96.488%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股 3.512% 的中外合资企业，注册资本 5,100 万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2016 年总资产为 260,370.14 万元；净资产为 119,769.10 万元；营业收入 219,729.42 万元；净利润 18,211.64 万元。

4、江阴新晟电子有限公司

为本公司控股 70% 的有限公司，注册资本 4,875 万元人民币，主营新型电子元器件的销售、研究、开发、设计、制造、加工。

2016 年总资产为 13,096.96 万元；净资产为 2,512.88 万元；营业收入 8,098.69 万元；净利润 -4,170.65 万元。

5、江阴新顺微电子有限公司

为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 1,060 万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。

2016 年总资产为 42,846.12 万元；净资产为 36,567.27 万元；营业收入 29,880.73 万元；净利润 4,288.37 万元。

6、长电国际（香港）贸易投资有限公司（下称“长电国际”）

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本 24,800 万美元，主营进出口贸易。

2016 年总资产 225,907.19 万元；净资产为 172,172.72 万元；营业收入 51,432.72 万元；净利润-58.11 万元。

7、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（长电韩国）

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶 SiP 产品封装测试。

2016 年总资产为 299,046.31 万元，净资产为 133,533.05 万元；营业收入 236,820.92 万元，净利润-4,901.35 万元。

8、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接控股的子公司，注册资本 30,000 万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

2016 年总资产为 74,911.40 万元，净资产为 56,974.95 万元；营业收入 3,676.17 万元，净利润-9,545.72 万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2017 年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

四、董事会意见

本公司现有担保均为向下属全资子公司或控股子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了

解，财务风险处于可控范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司累计担保余额为 438,284.17 万元人民币，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一七年四月十九日